



Fotoaccoppiatore per gate driver di Toshiba con corrente di uscita di picco da 2,5A in package a basso profilo

Il dispositivo ultra sottile garantisce 5kV di isolamento e distanze di isolamento in aria e superficiali pari a 8,0mm

Düsseldorf, Germania, 19 Aprile 2018 – Toshiba Electronics Europe ha annunciato oggi il lancio di un nuovo fotoaccoppiatore per gate driver alloggiato in un package SO8L a basso profilo. Il TLP5832 fornisce una corrente di uscita di picco pari a 2,5A (I_{OPH} , I_{OPL}) e può pilotare direttamente IGBT e MOSFET in applicazioni come gli inverter per le applicazioni industriali, i condizionatori d'aria e le applicazioni fotovoltaiche, e inoltre i servoamplificatori.

L'adozione del package SO8L fornisce un dispositivo che è alto appena 2,3mm - circa il 54% in meno rispetto ai prodotti attuali di Toshiba che sono disponibili in package SDIP6 e DIP8. Il package SO8L assicura il supporto alle moderne applicazioni, nelle quali spesso l'altezza e lo spazio di montaggio sono limitati.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, l'IC offre una tensione di isolamento (BV_S) di $5000V_{rms}$ e garantisce distanze di isolamento in aria e superficiali minime di 8,0mm, il che lo rende adatto per applicazioni che richiedono alte prestazioni di isolamento, inclusi i progetti critici per la sicurezza.

Inoltre, il nuovo TLP5832 garantisce un tempo di ritardo di propagazione (t_{PLH} , t_{PHL}) di 200ns e una deviazione del ritardo di propagazione (t_{Psk}) di ± 80 ns lungo l'intero intervallo di temperature operative da -40°C e $+110^{\circ}\text{C}$. È così possibile progettare circuiti inverter ad alta efficienza riducendo i margini di progettazione legati alla temperatura.

Le spedizioni dei dispositivi sono già iniziate.

###

Informazioni su Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) è la divisione Europea dedicata alla produzione di componenti elettronici di [Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation](#). TEE offre ai consumatori e alle aziende Europee un'ampia varietà di unità a disco rigido (HDD), oltre a soluzioni su semiconduttore per applicazioni automotive, industriali, IoT, per il controllo del movimento, telecom, di rete, consumer e per gli elettrodomestici. Il vasto portafoglio di prodotti della società comprende IC wireless integrati, semiconduttori di potenza, microcontrollori, semiconduttori ottici, ASIC, ASSP e dispositivi discreti che vanno dai diodi agli IC logici.

Fondata nel 1973 a Neuss in Germania, TEE ha sede principale a Düsseldorf in Germania, con filiali in Germania, Francia, Italia, Spagna, Svezia e nel Regno Unito con attività di progettazione, produzione, marketing e vendite. Il presidente della compagnia è il sig. Akira Morinaga.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web di Toshiba Electronics Europe all'indirizzo www.toshiba.semicon-storage.com.

Indirizzo di riferimento da pubblicare:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germania

Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197

Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

E-mail: discrete-ic@toshiba-components.com

Contatto per i giornalisti:

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +44 (0)193 282 2832

E-mail: MShrimpton@teu.toshiba.de

Comunicato emesso da:

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0) 20 8429 6554

Web: www.publitek.com

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com

Aprile 2018

Rif. 7118/A